

(Inoffizielle Übersetzung)

Bekanntmachung des Board of Investment

Nr. Sor. 4/2567

Änderungen zu Aktivität 4.2.4 Herstellung von elektronischen Leiterplatten und/oder Teilen von
Leiterplatten

Gemäß der Bekanntmachung des Board of Investment Nr. 9/2565 vom 8. Dezember 2022 über die Maßnahmen zur Investitionsförderung in Industrien, die für die Entwicklung des Landes wichtig sind und um die Investition in der Herstellung von elektronischen Leiterplatten (Printed Circuit Board: PCB) zu fördern, einschließlich der PCB-Hersteller, den Produzenten von Rohstoffen und notwendigen Materialien für den Produktionsprozess sowie den Dienstleistern, die einen wichtigen Teil der Lieferkette darstellen, sowohl von thailändischen als auch ausländischen Betreibern, mit dem Ziel, ein Cluster der PCB-Industrie in Thailand zu schaffen und zu entwickeln, erteilt das Board of Investment auf Grundlage von Abschnitt 16 des Investment Promotion Act B.E. 2520 die folgende Bekanntmachung.

Die Bestimmungen in der Aktivität 4.2.4 der Liste, die der Bekanntmachung des Boards of Investment Nr. 9/2565 vom 8. Dezember 2022 beigefügt ist, werden aufgehoben und durch die folgenden Bestimmungen ersetzt:

Aktivitäten	Bedingungen	Anreize
4.2.4 Die Herstellung von elektronischen Leiterplatten, Rohstoffen oder notwendigen Materialien für die Produktion von elektronischen Leiterplatten.		
4.2.4.1 Die Herstellung von High Density Interconnect (HDI) Printed Circuit Boards.	Es muss in Maschinen und Produktionsverfahren investiert werden, die vom BOI genehmigt werden.	A2
4.2.4.2 Die Herstellung von Flexible Printed Circuit Boards und Multilayer Printed Circuit	1. Es muss eine Investition in Maschinen (einschließlich Installations- und Testkosten) in Höhe von mindestens 1.500 Millionen Baht	A2

Aktivitäten	Bedingungen	Anreize
Boards, die als Großinvestition gelten.	<p>getätigt werden, die für die Produktion verwendet werden.</p> <p>2. Es muss ein Verfahren zur Erstellung von Schaltmustern vorhanden sein.</p>	
4.2.4.3 Die Herstellung von Flexible Printed Circuit Boards und Multilayer Printed Circuit Boards.	Es muss ein Verfahren zur Erstellung von Schaltmustern vorhanden sein.	A3
4.2.4.4 Die Herstellung von Printed Circuit Boards.	Es muss ein Verfahren zur Erstellung von Schaltmustern vorhanden sein.	B
4.2.4.5 Die Unterstützung von Produktionsprozessen für Printed Circuit Boards, die wesentliche Verfahren umfassen.	<p>1. Es muss ein wesentlicher Produktionsprozess für Printed Circuit Boards vorhanden sein, der Folgendes umfasst:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Schichtbeschichtung (Lamination) - Bohrung von Werkstücken (Drilling) - Oberflächenveredelung (Plating) - Zuschnitt von Werkstücken (Routing) <p>2. Im Fall einer Investition in Maschinen, die für die Produktion verwendet werden (einschließlich Installations- und Testkosten), muss diese mindestens 1 Milliarde Baht betragen.</p> <p>3. Sonstige Fälle.</p>	A4
4.2.4.6 Die Herstellung von wichtigen Rohstoffen für die Produktion von Printed Circuit Boards, einschließlich Copper Clad Laminate (CCL), Flexible	1. Im Fall einer Investition in Maschinen, die für die Produktion verwendet werden (einschließlich Installations- und Testkosten), muss diese mindestens 1,5 Milliarden Baht betragen.	B A2

